

TECHNICAL SPEC FOR Wet processing system

System Model:

DNS 80B

Specific Model: 700304088A

Wafer size: 6 inch

Process: DI water rinse

Chemicals used: DI water, Co2

Wafer material: Jeida flat

SMIF: no

Indexer Robot: yes

Transfer Robot: yes

Front-Side Spin Scrub Units: 2 (Nanospray)

Back-Side Spin Scrub Units: 2 (Softspray)

Reverse Unit: Yes

OF/Notch: OF (Jeida)

Pumps: NA

Controllers:

SECS: yes

Vintage:

Missing parts: none

Defected parts: none

Software:

Operating system:

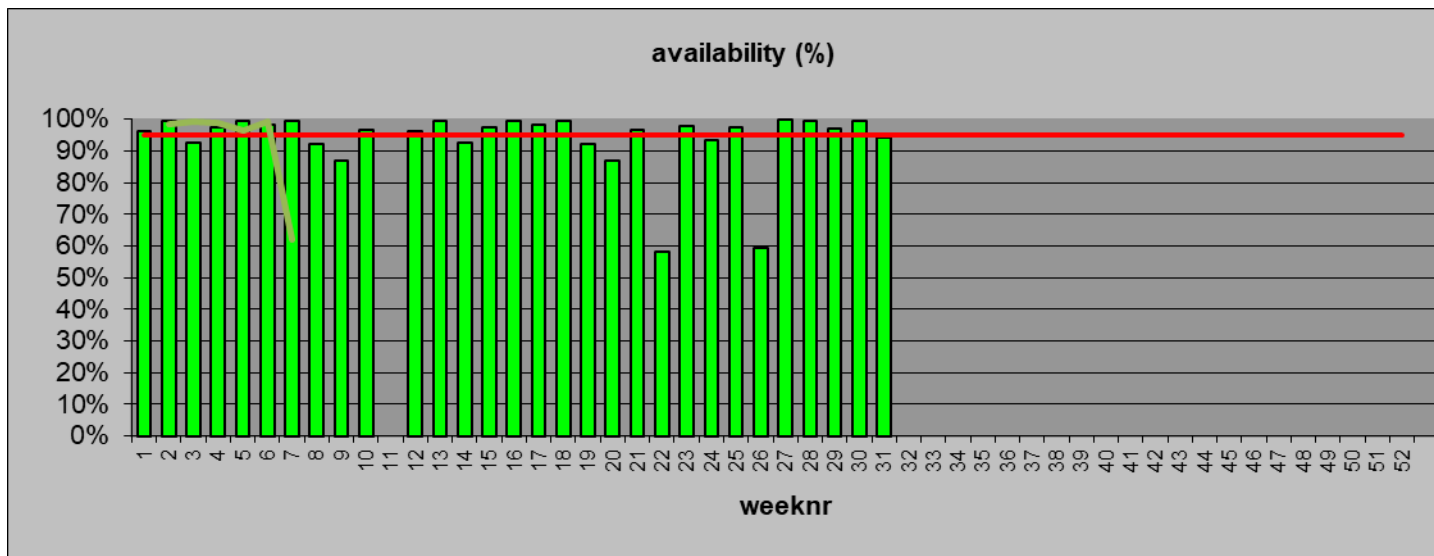
TOP MENU		1		SYSTEM INFORMATION		20/02/27 15:16:01	
SYSTEM INFORMATION 2							
CAS. END							
☐ LU IDA ☐ LU 1 ☐ LU ☐ LU	SSV 5 SSV 6 SSM 3	SSV 6 SSM 4	HP10 HP 9 HP 8 CP 7 TR 2 R12 R11	SYS. Ver 100C NON TACT MODE STAT' N TACT1 20.0 STAT' N TACT2 0.0 STAT' N TACT3 0.0 STAT' N TACT4 0.0 HOST : ONLINE AGV : OFFLINE EXP : ONLINE LOT1 CNT(ID): 10 LOT2 CNT(ID): 10 LOT1 CNT(IF): 0 LOT2 CNT(IF): 0 TOWER LAMP 1 2 3 4 5 6 7 8			
UNIT INFORMATION							
MODE ALARM STATUS B1 I/D: AUTO NO READY P/R: AUTO NO READY							
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
WAFER	UNIT	ALL UNIT	COUNTER	NEXT	PREV	TOP	

SPRAY1 – SPRAY2 – SPRAY3: Configuratie

Spray1&2	Product	Toepassing
Spinstation 3 en 4	Softspray	Cleanen van wafers voornamelijk achterkant
Spinstation 5 en 6	Nanospray	Cleanen van wafers alleen voorzijde want de wafer ligt op een chuck
Cold plate	Koude plaat	koeling
Hot plate	Hete plaat	<u>drogen</u>

Spray3	Product	Toepassing
Spinstation 3, 4, 5 en 6	Nanospray	Cleanen van wafers alleen voorzijde want de wafer ligt op een chuck

Spray4	Product	Toepassing
Spinstation 3 en 4	<u>Softspray</u>	Cleanen van wafers voornamelijk achterkant
<u>Spinstation 5 en 6</u>	<u>Softspray</u>	Cleanen van wafers alleen voorzijde want de wafer ligt op een chuck
Cold plate	Koude plaat	koeling
Hot plate	Hete plaat	<u>drogen</u>



Photos to Collect

- All 4 sides
- Process module
- Control panel
- Chemical cannisters

- Gauges/Valves
- Pumps
- Inside all cabinets (boards, electronics and chemicals)
- Serial plate
- Spare parts, manuals (if any)